

证券研究报告·行业动态

周报：模拟 IC 大厂集中开启新一轮涨价；比亚迪发布智驾芯片

核心观点

半导体：模拟IC大厂开启新一轮集体涨价，AI需求外溢与成本压力驱动行业步入价格反弹新周期。

消费电子：英伟达联手微软、Arm 同步预热“PC 新纪元”，自研 Arm 架构处理器有望打破苹果与高通垄断并定义本地 AI 算力入口。

汽车电子：比亚迪发布首款自研 4nm 智驾芯片“璇玑 A3”并推出安全兜底政策，将直接驱动高阶智驾在主流消费市场的加速渗透。

行业动态信息

1、半导体：模拟 IC 大厂开启新一轮集体涨价，AI 需求外溢与成本压力驱动行业步入价格反弹新周期。

英飞凌于 5 月 26 日发出通知，计划于 2026 年 7 月 1 日起调整部分产品价格，为年内第二次提价。意法半导体（ST）则于 5 月 28 日宣布，拟自 2026 年 6 月 28 日起对部分产品进行价格上调，这是其继 4 月 26 日调价后的年内第二次动作。模拟龙头德州仪器（TI）先前已宣布自 7 月 1 日起调涨电源管理 IC 等核心产品报价。此外，矽力杰也宣布自 7 月 1 日起对部分产品线进行差异化调价，而 MPS、ADI 等厂商也在此前陆续完成了不同程度的价格上修。

从驱动因素来看，本轮涨价呈现出“成本推升”与“AI 拉动”的双重特征。多数厂商在涨价函中强调了原材料、能源、运输及劳动力成本持续攀升带来的运营压力。但更深层次的变革在于 AI 需求的正向外溢：AI 正从 GPU、HBM 等核心算力环节，向电源管理、信号链等模拟 IC 环节持续扩散。随着 AI 服务器功耗的急剧提升，光模块、交换机等配套基础设施对高性能模拟器件的用量和规格要求同步翻倍。英飞凌 CEO Jochen Hanebeck 指出，凭借 AI 数据中心电源解决方案的强劲需求以及汽车业务订单的回暖，公司不仅达成上半年目标，更全面上调了全年业绩指引。这种由“AI 硬需求”驱动的结构性的复苏，正在抵消传统消费电子领域的疲软，倒逼产业链向高性能、高价值环节加速转型。

模拟 IC 板块正处于从“库存周期修复”向“需求修复+价格反弹+结构升级”切换的关键窗口。海外龙头的密集提价不仅为行业打开了价格空间，也有效缓解了国内厂商此前因低价竞争带来的盈利压力，推动行业毛利率水平企稳回升。对于产业链而言，具备 AI 服务器电源、高阶光模块等产品布局的国产模拟厂商将率先享受这一波“推理红利”带来的盈利弹性。未来几个季度，随着 AI 基建支出持续放量，掌握高性能、低延迟模拟技术的领军企业，将在这一轮由 AI 定义的行业重塑中持续占据竞争优势。

电子

维持

强于大市

何昊

hehaodzz@csc.com.cn

SAC 编号：S1440526030011

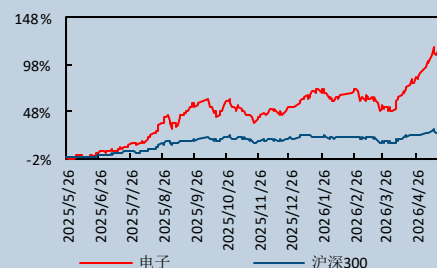
何昱灵

heyuling@csc.com.cn

SAC 编号：S1440524080001

发布日期：2026 年 06 月 01 日

市场表现



相关研究报告

26.05.25

【中信建投电子】周报：长江存储启动 IPO 辅导，MLCC 价格有望迎来反转

2、消费电子：英伟达联手微软、Arm 同步预热“PC 新纪元”，自研 Arm 架构处理器有望打破苹果与高通垄断并定义本地 AI 算力入口。

近期，英伟达微软与 Arm 先后发布了以“A new era of PC”（PC 的新纪元）为主题的相关推送，共同指向即将到来的台北国际电脑展（Computex）。市场普遍预期，英伟达将在大会期间正式发布面向 Windows PC 的 Arm 架构处理器 N1/N1X。若该产品正式落地，将意味着英伟达在数据中心 AI 霸权之外，正式切入端侧 PC 处理器市场。这不仅有望打破苹果在 Arm PC 市场的长期领先格局，以及高通在 Windows on Arm 生态中的主导地位，更标志着英伟达开始围绕端侧 AI 算力入口展开战略布局。

相较于高通或传统 x86 平台，英伟达的优势不仅在于 CPU 架构的变化，更在于其有望将顶尖的 NVIDIA GPU、成熟的 AI 软件栈（如 CUDA、TensorRT）与 Microsoft Windows/Copilot 生态进行深度融合。随着推理拐点到来，高端 PC 的评估标准正从单纯的主频博弈转向以“Token 生产效率”为核心的价值重估，从而开启一波由 AI 原生需求驱动的高质量换机红利。

3、汽车电子：比亚迪发布首款自研 4nm 智驾芯片“璇玑 A3”并推出安全兜底政策，将直接驱动高阶智驾在主流消费市场的加速渗透。

比亚迪于 2026 年 5 月 28 日正式发布中国首款自研 4nm 车规级智驾芯片——“璇玑 A3”，标志着其在智能汽车核心芯片领域取得重大突破。王传福董事长强调，璇玑 A3 的研发难度远超消费级 4nm 芯片，其成功量产使比亚迪成为全球唯一拥有芯片产品定义、架构设计、晶圆制造及封测全流程能力的汽车企业。与此同时，比亚迪推出了搭载该芯片的“天神之眼”智驾方案，并配套发布了行业首创的“城市领航安全兜底”政策，旨在通过为新用户提供为期一年的安全保障服务，在自动驾驶向高阶演进的关键期重塑市场信心。

璇玑 A3 采用先进的 4nm 制程工艺，内置 16 核 CPU 架构，主频高达 2.5GHz，DMIPS 算力达 420K，内存带宽能力为 273GB/s。在算力释放上，通过三颗璇玑 A3 芯片组合可提供超过 2100 TOPS 的综合算力，单颗算力在 700 TOPS 以上，足以支持 L3 及 L4 级别自动驾驶系统的运行需求。对比行业同级别产品，璇玑 A3 在实现算力利用率大幅提升。为支撑这一算力布局，比亚迪已组建超过 7000 人的芯片研发团队，累计芯片研发投入超过 1000 亿元，并拥有 5 座晶圆制造厂，目前车规级芯片已覆盖 13 大类、566 款产品。

比亚迪在发布会上同步推出了行业首创的“城市领航安全兜底”政策，为搭载天神之眼高阶智驾系统的新用户提供为期一年的安全兜底服务，涵盖车辆维修及人身伤害损失，且具有“免费、无上限、不影响次年保费”等特性。这种“自研硬核芯片+厂家安全背书”的组合拳，旨在高阶自动驾驶落地的关键期，通过技术冗余与制度创新的双重手段，降低消费者对智驾安全性的顾虑并重塑市场信心。

4、投资建议：

半导体：算力芯片（海光信息、龙芯中科）、存储（兆易创新、北京君正）、AIoT（瑞芯微）、射频（唯捷创芯、卓胜微）、模拟（思瑞浦、纳芯微）、设备（长川科技）；

消费电子：立讯精密、长盈精密、水晶光电、华勤技术；

PCB 及被动元件：鹏鼎控股、东山精密、深南电路、三环集团、顺络电子、洁美科技。

5、风险提示：

未来中美贸易摩擦可能进一步加剧，存在美国政府将继续加征关税、设置进口限制条件或其他贸易壁垒风险；宏观环境的不利因素将可能使得全球经济增速放缓，居民收入、购买力及消费意愿将受到影响，存在下游需求不及预期风险；大宗商品价格仍未企稳，不排除继续上涨的可能，存在原材料成本提高的风险；全球政治局势复杂，主要经济体争端激化，国际贸易环境不确定性增大，可能使得全球经济增速放缓，从而影响市场需求结构，存在国际政治经济形势风险。

目录

一、行情回顾	1
二、行业数据	2
三、产业要闻	5
3.1 半导体	5
3.2 消费电子	6
3.3 汽车电子	6
3.4 面板	6
四、重要公告	7
五、风险分析	8

图表目录

图表 1：电子行业重要指数涨跌幅情况	1
图表 2：电子行业每周股价涨幅前五名	1
图表 3：电子行业每周股价跌幅前五名	1
图表 4：日本半导体设备出货金额及同比	2
图表 5：全球半导体月度销售额	2
图表 6：DDR4 价格走势（16Gb，USD）	2
图表 7：DDR5 价格走势（16Gb，USD）	2
图表 8：Flash Wafer 价格走势（512Gb TLC，USD）	2
图表 9：Flash Wafer 价格走势（1Tb TLC，USD）	2
图表 10：全球智能手机市场各品牌份额	3
图表 11：中国智能手机市场各品牌份额	3
图表 12：2026 年中国智能手机市场各品牌周度出货量（千台）	3
图表 13：全球液晶电视面板月度出货量	3
图表 14：全球液晶面板月度营收	3
图表 15：TV 面板价格趋势	4
图表 16：Monitor 面板价格趋势	4
图表 17：Notebook 面板价格趋势	4
图表 18：台股 MLCC 月度营收及同比	4
图表 19：一周重要公告	7

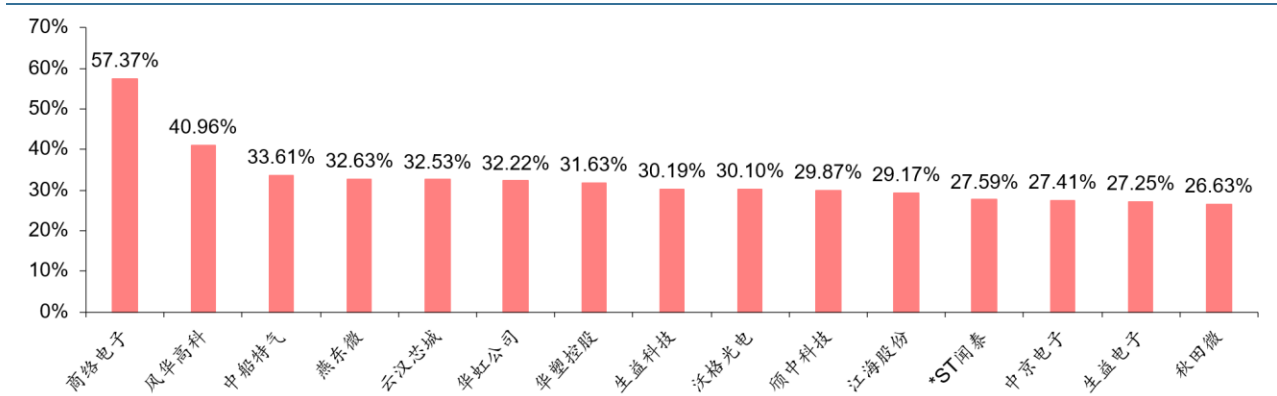
一、行情回顾

图表1： 电子行业重要指数涨跌幅情况

代码	名称	周报点	周涨跌幅	月涨跌幅	年涨跌幅
000001.SH	上证指数	4068.57	-1.08%	-1.06%	2.51%
399001.SZ	深证成指	15575.13	-0.14%	3.10%	15.16%
399006.SZ	创业板指	4037.95	2.53%	9.81%	26.06%
000300.SH	沪深300	4892.12	0.97%	1.76%	5.66%
801080.SI	电子(申万)	9558.91	-0.35%	17.88%	45.84%
SOX.GI	费城半导体指数	12829.38	5.14%	22.14%	81.13%
TWSE020	台湾电子指数	2928.42	6.39%	17.25%	68.55%
TWSE071	台湾半导体指数	1530.59	5.99%	17.57%	66.85%

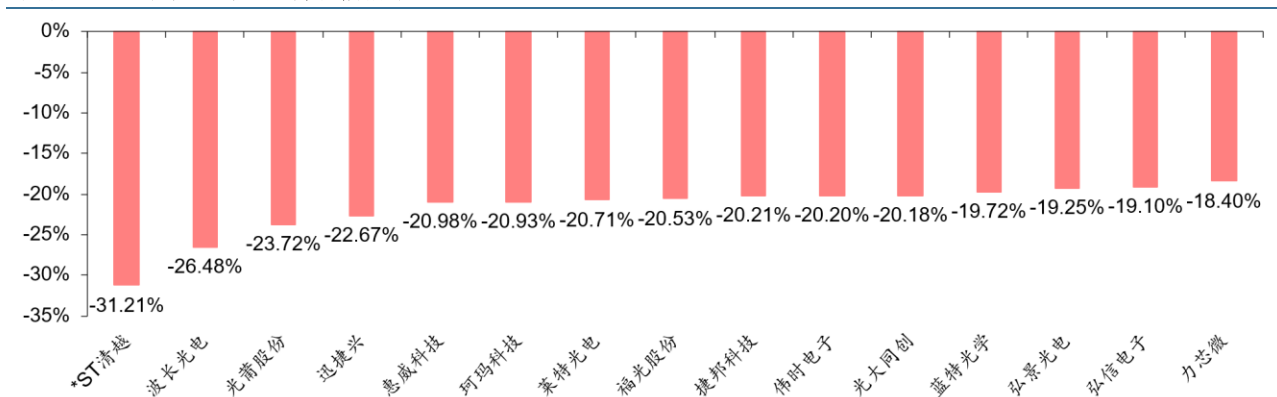
资料来源：Wind，中信建投

图表2： 电子行业每周股价涨幅前五名



资料来源：Wind，中信建投

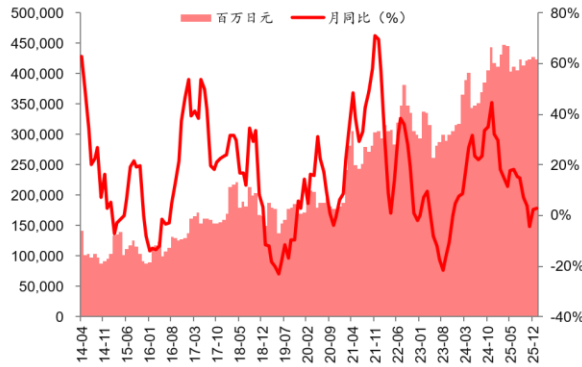
图表3： 电子行业每周股价跌幅前五名



资料来源：Wind，中信建投

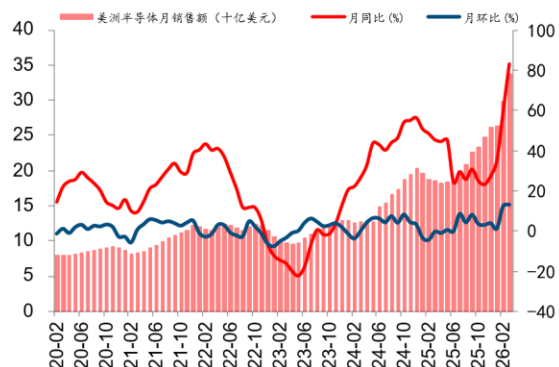
二、行业数据

图表4: 日本半导体设备出货金额及同比



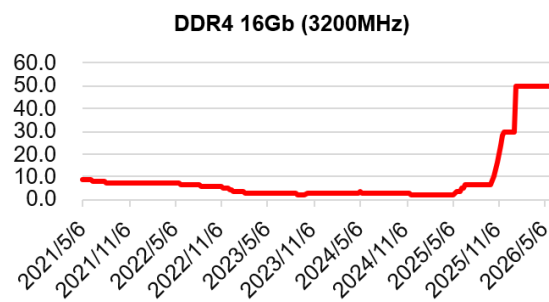
资料来源: Wind, 中信建投

图表5: 全球半导体月度销售额



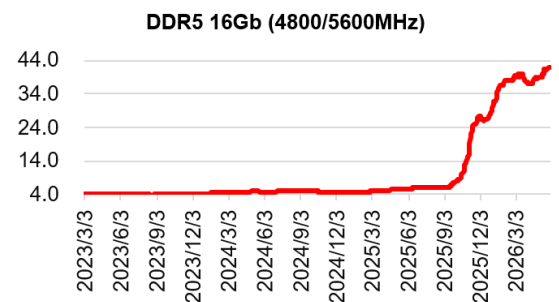
资料来源: Wind, 中信建投

图表6: DDR4 价格走势 (16Gb, USD)



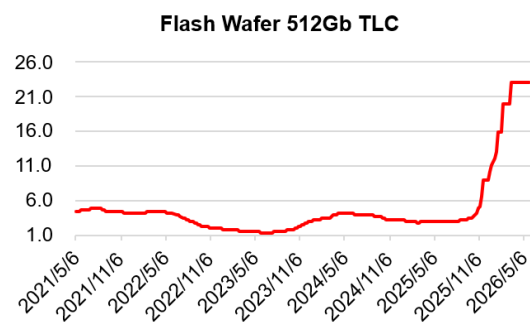
资料来源: CFM, 中信建投

图表7: DDR5 价格走势 (16Gb, USD)



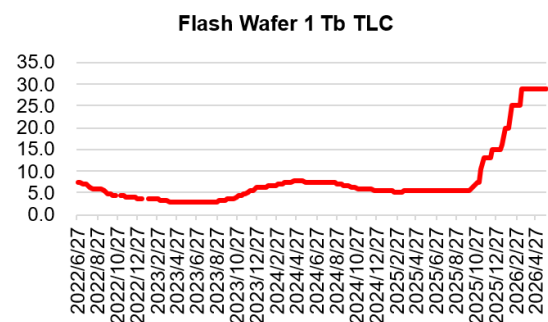
资料来源: DRAMexchange, 中信建投

图表8: Flash Wafer 价格走势 (512Gb TLC, USD)



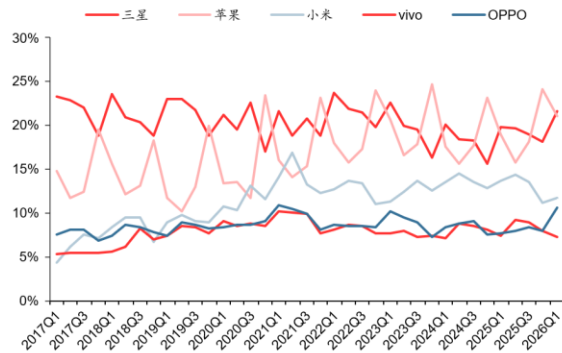
资料来源: CFM, 中信建投

图表9: Flash Wafer 价格走势 (1Tb TLC, USD)



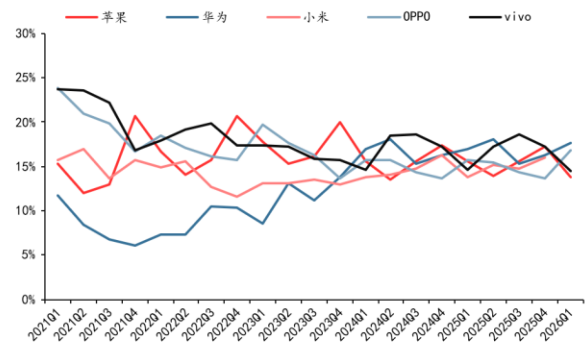
资料来源: CFM, 中信建投

图表10： 全球智能手机市场各品牌份额



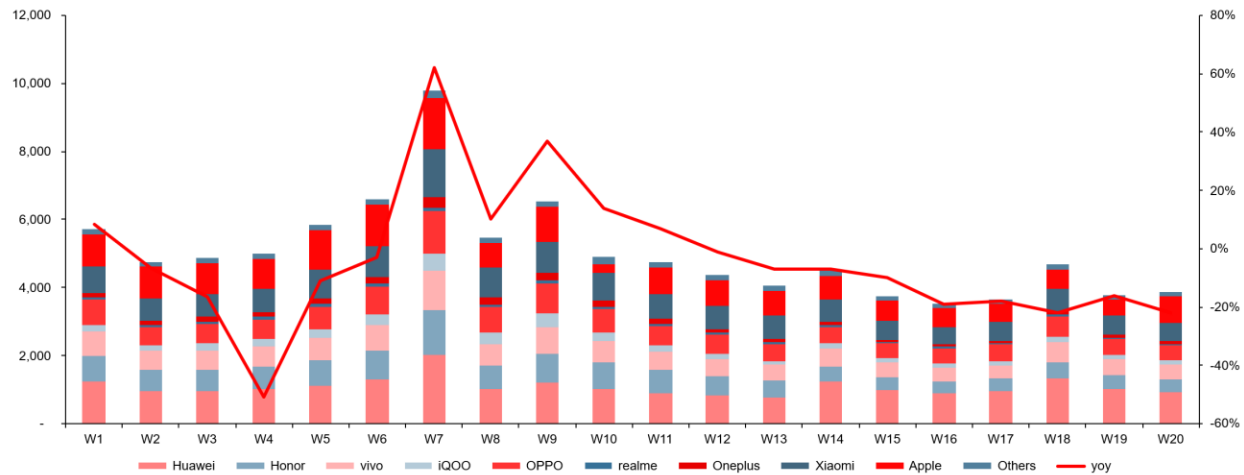
资料来源：IDC，中信建投

图表11： 中国智能手机市场各品牌份额



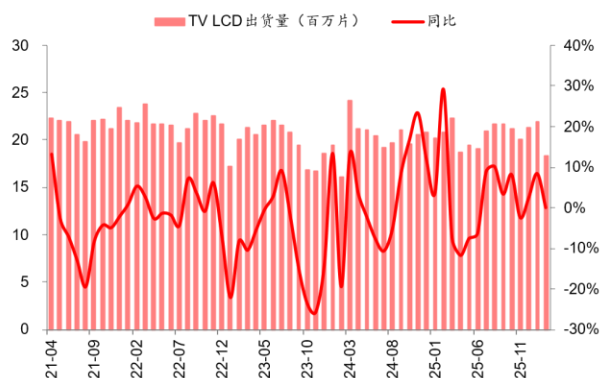
资料来源：IDC，中信建投

图表12： 2026 年中国智能手机市场各品牌周度出货量（千台）



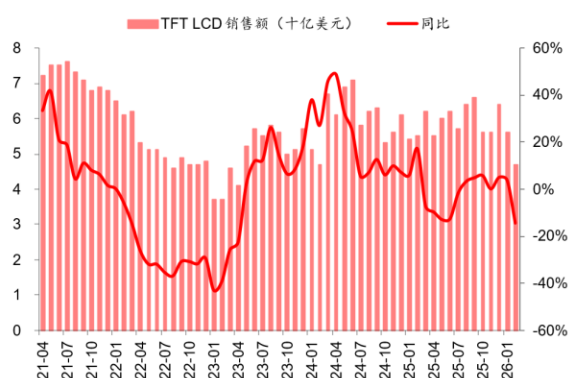
资料来源：BCI，中信建投

图表13： 全球液晶电视面板月度出货量



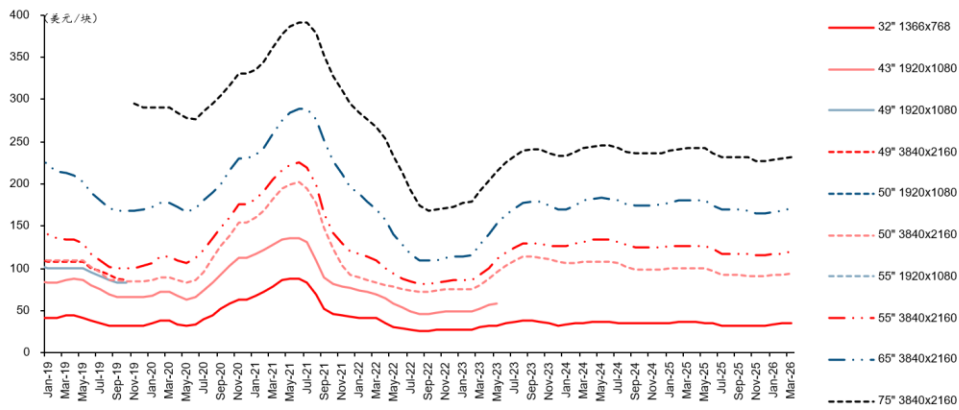
资料来源：Wind，中信建投

图表14： 全球液晶面板月度营收



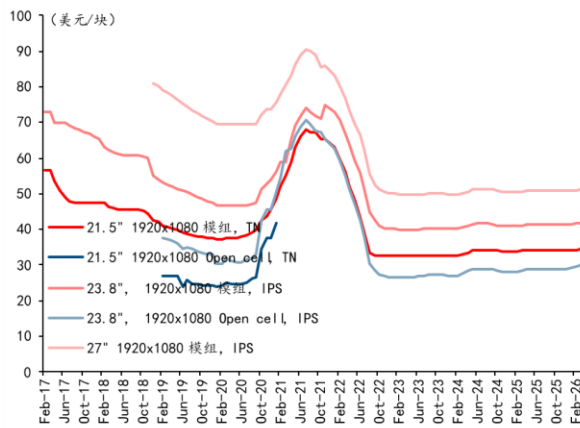
资料来源：Wind，中信建投

图表15: TV 面板价格趋势



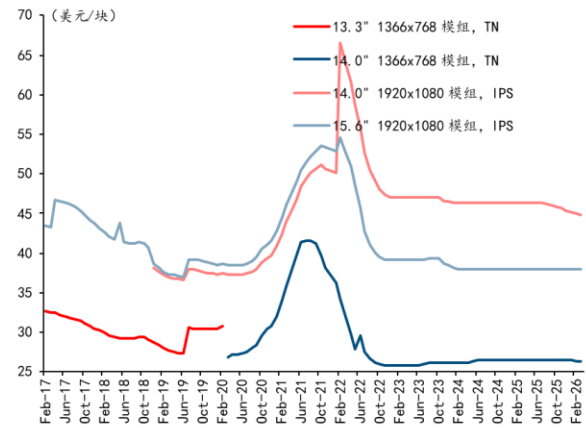
资料来源: 群智咨询, 中信建投

图表16: Monitor 面板价格趋势



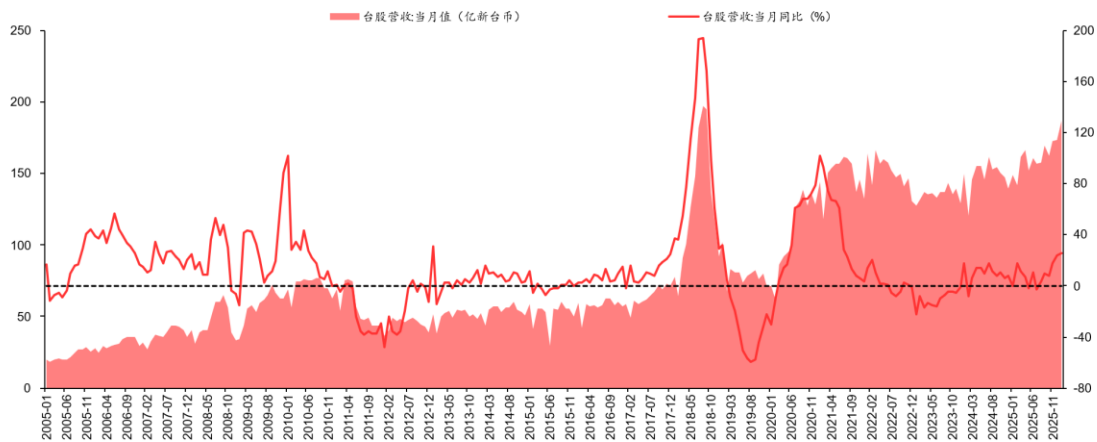
资料来源: 群智咨询, 中信建投

图表17: Notebook 面板价格趋势



资料来源: 群智咨询, 中信建投

图表18: 台股 MLCC 月度营收及同比



资料来源: Wind, 中信建投

三、产业要闻

3.1 半导体

【2026 年 Q1 全球五大 NAND 闪存原厂合计营收环比增幅高达 83.7%】TrendForce 的数据显示，全球五大 NAND 闪存原厂 2026 年 Q1 该部分业务合计营收在 ASP（平均销售单价）普遍优于预期的带动下达 389 亿美元（现约合 2645.82 亿元人民币），环比增幅高达 83.7%。其中，三星电子的 NAND 营收季度增幅达到 104.7%，为五大原厂最高；美光、闪迪也均取得 96.7%环比提升；铠侠 QoQ 数据为+80.0%；相对增幅较低的 SK 海力士也有 44.6%的提升。（TechSugar）

【长鑫科技科创板 IPO 成功过会】5 月 27 日，上海证券交易所上市审核委员会召开 2026 年第 27 次审议会议结果显示，长鑫科技集团股份有限公司科创板 IPO 成功过会。这标志着中国规模最大、技术最先进的 DRAM 研发设计制造一体化企业正式迈入资本市场新阶段，也意味着中国半导体存储产业迎来关键里程碑。长鑫科技此次 IPO 拟募集资金高达 295 亿元，将主要用于存储器晶圆制造量产线技术升级改造项目、DRAM 存储器技术升级项目，以及 DRAM 前瞻技术研究与开发项目。（TechSugar）

【联电下半年将采取选择性小幅度涨价】据台媒消息，芯片制造商联电首席财务官刘启东表示，随着新加坡厂扩产，成本较昂贵，面临较大困难，今年下半年展开选择性涨价，2027 年将更全面与客户就价格调整进行商议。刘启东透露，联电第二季度整体平均产能利用率达 85%，其中 12 英寸厂优于平均，包括新加坡及厦门厂均接近满载，南科厂则仍有空间。8 英寸厂整体虽略低于整体平均，因需求随着近期景气回温而改善，也有部分厂区满载。（TechSugar）

【英飞凌牵头启动欧盟 Moore4Power 计划】英飞凌宣布启动由其担任协调方的欧盟 Moore4Power 计划，来自 15 个国家的 62 家参与方将联手开发更高效、更可靠、更易于产业化的新一代先进智能电力电子产品。该项目目标以系统级创新来应对传统尺寸缩放在推进“摩尔定律”上的失速，以更智能、更贴近应用的方式整合技术、材料和功能。为此 Moore4Power 以异构集成为核心，硅（Si）、碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等材料都将被用于最适合的领域，通过“功率芯粒”（Power Chiplet）实现扬长避短。（TechSugar）

【时隔两个月，意法半导体再度涨价】5 月 28 日，MCU 及功率半导体大厂意法半导体（STMicroelectronics）向客户发出了“价格调整通知函”，宣布将自 2026 年 6 月 28 日起对部分产品价格进行上调。这是意法半导体在今年 3 月 24 日宣布将多个产品线的价格自 4 月 26 日起进行上调之后，今年以来的第二度宣布涨价。显然，仅时隔两个月，意法半导体再度宣布调价，凸显出成本端压力的持续加剧。（TechSugar）

【Marvell 上调未来两年营收目标】当地时间 5 月 27 日盘后，芯片大厂 Marvell 公布了其 2027 财年第一财季财报，不仅营收和利润双双超越指引，更罕见地大幅上调了后续财年的业绩展望，推动其盘后股价一度大涨 6%。Marvell 预计 2027 财年第二季度（截至 2026 年 8 月 1 日）营收将达到 27 亿美元（上下浮动 5%）；GAAP 稀释每股收益预计为 0.37 美元（上下浮动 0.05 美元）；Non-GAAP 稀释每股收益为 0.93 美元（上下浮动 0.05 美元）。（TechSugar）

3.2 消费电子

【2026 年 Q1 欧洲智能手机市场同比增长 2%】Omdia 发布研究数据称，2026 年第一季度，欧洲智能手机市场（不含俄罗斯）同比增长 2%至 3300 万部。尽管供应链成本持续上升、产品供应风险增加，市场仍展现出一定韧性。优秀的终端用户需求以及渠道提前备货，共同推动了市场增长。Omdia 表示，2026 年第一季度，欧洲智能手机平均售价（ASP）达到 580 欧元（现约合 4585 元人民币），创历史纪录。这主要是由于 200 欧元以下机型供应减少，此类产品在整体出货中的占比降至历史最低，仅为 25%。（TechSugar）

【4 月国内市场手机出货量 2573.3 万部，同比增长 2.8%】中国信通院数据显示，2026 年 4 月，国内市场手机出货量 2573.3 万部，同比增长 2.8%，其中，5G 手机 2473.6 万部，同比增长 24.4%，占同期手机出货量的 96.1%。2026 年 1-4 月，国内市场手机出货量 8653.8 万部，同比下降 8.6%，其中，5G 手机 8020.3 万部，同比下降 0.9%，占同期手机出货量的 92.7%。（TechSugar）

【中东智能手机市场预计将下滑 22%】Omdia 近日发布研究，2026 年第一季度，中东智能手机市场（不含土耳其）同比下降 6%至 1100 万部。报告称，尽管在斋月前以及新品发布周期推动下，渠道进行了显著的库存前置备货，但零售端实际动销疲软以及消费者谨慎情绪持续抑制了换机需求。与此同时，全球内存成本持续通胀推动智能手机价格在新旧产品线中全面上涨，促销空间受到明显压缩。季度末地缘政治紧张局势进一步扰乱区域供应链运作，并对消费者信心形成额外压力。（TechSugar）

3.3 汽车电子

【2026 年 Q1 全球新能源汽车销量同比下降 2%】据 TrendForce 统计数据显示，2026 年第 1 季度全球新能源车销量为 394 万辆，同比下降 2%，占全球汽车销量 19%。纯电动车市场方面，特斯拉在本季度反超比亚迪，重新拿下全球销量冠军。排名第 2 至第 4 位的比亚迪、吉利、上汽通用五菱，销量都低于去年同期。零跑则依靠更快的产品扩张和性价比策略，在逆风中保持增长。（TechSugar）

3.4 面板

【传 LG 电子出售电视业务，国内这家显示大厂已进行接触】5 月 28 日消息，韩媒 EBN 当地时间今日报道称，LG 电子 (LG Electronics) 高管在近日的中国北京行程中与海信 (Hisense) 高管就业务重组计划进行了协调磋商，而这其中就包括就出售电视业务部门的可能性。报道援引 Omdia 的数据指出，LG 电子近年来在全球电视市场的出货量占比一直处于 10% 左右，已低于 TCL、海信等竞争对手。（CINNO）

四、重要公告

图表19：一周重要公告

公司名称	发布日期	公告内容
必易微	2026/5/27	根据 2026 年 5 月 27 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 56.56 元/股。参与本次询价转让报价的机构投资者家数为 20 家，涵盖了基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、私募基金管理人等专业机构投资者。本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 17 家机构投资者，拟受让股份总数为 2,786,482 股。
金宏气体	2026/5/28	2026 年 5 月 27 日，公司收到董事兼高级管理人员师东升先生出具的《关于股份减持计划实施结果的告知函》。截至 2026 年 5 月 27 日，师东升先生通过集中竞价交易方式共减持公司股份 21,500 股，占公司当前总股本的 0.0040%。
生益科技	2026/5/29	广东生益科技股份有限公司董事长陈仁喜先生持有公司股份 2,245,450 股，约占公司总股本（2,429,119,230 股，下同）的 0.0924%。陈仁喜先生因自身资金需求，计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持其所持公司无限售条件流通股不超过 335,762 股，不超过其持股总数的 25%，减持价格按照减持实施时的市场价格为准。

来源：Wind，中信建投

五、风险分析

未来中美贸易摩擦可能进一步加剧，存在美国政府将继续加征关税、设置进口限制条件或其他贸易壁垒风险；宏观环境的不利因素将可能使得全球经济增速放缓，居民收入、购买力及消费意愿将受到影响，存在下游需求不及预期风险；大宗商品价格仍未企稳，不排除继续上涨的可能，存在原材料成本提高的风险；全球政治局势复杂，主要经济体争端激化，国际贸易环境不确定性增大，可能使得全球经济增速放缓，从而影响市场需求结构，存在国际政治经济形势风险。

分析师介绍

何昊：复旦大学管理学硕士，2020 年起先后就职于国海证券、光大证券研究所担任电子行业分析师，2026 年入职中信建投证券，主要覆盖消费电子等领域。

何昱灵：电子行业分析师。复旦大学硕士，2022 年加入中信建投电子团队，专注研究模拟 IC 领域。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普500指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15%以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅 10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：（i）以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。（ii）本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
朝阳区景辉街16号院1号楼18层
电话：（8610）8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路528号南塔2103室
电话：（8621）6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区福中三路与鹏程一路交汇处广电金融中心35楼
电话：（86755）8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：（852）3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk